

Title (en)

Method for attaining a temperature in a metal bath.

Title (de)

Verfahren zum Erzielen einer Temperatur einer Metallschmelze.

Title (fr)

Procédé pour porter à une température un bain métallique.

Publication

**EP 0403035 A2 19901219 (DE)**

Application

**EP 90250080 A 19900322**

Priority

DE 3915619 A 19890512

Abstract (en)

The invention relates to a method for achieving a time characteristic of a metal melt in a ladle, the heating energy being generated by at least one plasma torch. Here, various values, such as, inter alia, the mass, the specific values of the melt in the ladle and plant parameters, are input into an adaptive control and the heating power is determined therefrom. The actual temperature of the melt is furthermore continuously measured and likewise taken into account in this process.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verfahren zum Verwirklichen eines Zeitlichen Verlaufes einer Metallschmelze in einer Pflanne, wobei die Heizenergie durch mindestens einen Plasmabrenner erzeugt wird. Hier werden verschiedene Werte wie u.s. die Masse, die spezifischen Werte der in der Pflanne befindlichen Schmelze sowie Anlagenparameter in eine adaptive Steuerung eingegeben, und hieraus wird die Heizleistung ermittelt. Weiterhin wird fortlaufend die tatsächliche Temperatur der Schmelze gemessen und ebenfalls hierbei berücksichtigt.

IPC 1-7

**B22D 2/00**; **B22D 11/10**; **B22D 11/18**; **C21C 7/00**

IPC 8 full level

**B22D 41/005** (2006.01); **B22D 2/00** (2006.01); **B22D 11/10** (2006.01); **B22D 11/11** (2006.01); **B22D 11/18** (2006.01); **B22D 46/00** (2006.01); **C21C 7/00** (2006.01); **F27B 3/28** (2006.01); **F27D 11/08** (2006.01); **F27D 19/00** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**B22D 2/006** (2013.01 - EP US); **B22D 11/11** (2013.01 - EP US); **B22D 41/05** (2013.01 - KR)

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0403035 A2 19901219**; **EP 0403035 A3 19910327**; **EP 0403035 B1 19940119**; DE 3915619 A1 19901115; DE 59004280 D1 19940303; JP 2925655 B2 19990728; JP H03468 A 19910107; KR 900017697 A 19901219; US 5081640 A 19920114; ZA 903344 B 19910227

DOCDB simple family (application)

**EP 90250080 A 19900322**; DE 3915619 A 19890512; DE 59004280 T 19900322; JP 12395890 A 19900514; KR 900005162 A 19900413; US 52217690 A 19900511; ZA 903344 A 19900502